

3D-heterogene Systemintegration Mikro- und Sensorsystem

PRODUCT
Image
Unavailable

PRODUCT
Image
Unavailable

Um Systeme komplexer, multifunktionaler und reaktiver zu gestalten, bedarf es weitere Anstrengungen in Richtung heterogener Systemintegration und 3D-Integrationstechniken. Auf einem Treffen des Sächsischen Arbeitskreises Elektronik-Technologie in der AB Elektronik Sachsen GmbH, auf dem Frühjahrsseminar der IMAPS Deutschland, in der Microelectronic Packaging GmbH (MPD) und im Fraunhofer-IZM-ASSID stellten Entwickler und Fertiger ihre Anstrengungen zum Erreichen solcher Ziele dar. Europa soll in den nächsten zehn Jahren bis zu 60 Prozent der neuen Elektronikmärkte erobern und den wirtschaftlichen Wert der Halbleiterkomponentenfertigung verdoppeln. Dies sieht ein Plan vor, der der Europäischen Kommission Ende Februar von der Electronics Leaders Group (ELG), elf Vorstandschefs sowie Institutsdirektoren der Elektronikbranche, vorgelegt wurde. Dazu muss sich die Branche auf Marktsegmente konzentrieren, in denen Europa stark ist. Insbesondere sollen Applikationen für das „Internet der Dinge“ und für intelligente Produkte und Dienste der Zukunft (Smart-Home-Systeme, Smart-Grids, Smart Factory oder Industrie 4.0) entwickelt werden.

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

ermäßigter Preis 2,52 €

2,70 €

Netto-Preis: 2,52 €

Enthaltene MwSt.: 0,18 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)